



MARCH FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS

适用于半导体封装应用的高产能等离子工艺的料条组件

FlexTRAK®-CD与FlexTRAK®-CDS系统

具备以下功能：

- 预芯片贴装、预引线键合、预成型封装和预底部填充等离子处理功能
- 图形用户界面(GUI)触摸屏操作便捷
- 具有生产待料的料条处理系统
- 等离子腔体紧凑、清洗过程较短，具有专用的过程控制系统，可实现最大产能和最低成本
- 生产灵活性无法比拟，支持多种料条尺寸
- 仅需拉出前方挂架，即可维护服务组件

主要应用

等离子去污和表面清洗

- 氟和其他卤素
- 金属和金属氧化物
- 有机化合物

蚀刻和表面粗化

- 提高粘晶和打线的粘合力
- 提高塑封胶粘合力，降低分层

表面活化

- 提高粘晶胶流动性，消除空洞，提高粘合力
- 提高塑封材料流动性，消除空洞，降低打线偏离率
- 提高底部填充物流动性，消除空洞，增强粘合力，提高芯吸速度

MARCH FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS

规格

外壳尺寸	W(宽)xD(长)xH(高) - 占地面积	FlexTRAK-CD: 1068宽x1166长x1600高; 高1966mm, 带灯塔 (42宽x46长x63高; 包含灯塔高度为77英寸)
		FlexTRAK-CDS: 1190宽x1320长x1640高; 包含灯塔高度为2114mm (47宽x52长x65高; 包含灯塔高度为83英寸)
	净重	FlexTRAK-CD: 430公斤 (948磅)
		FlexTRAK-CDS: 550公斤 (1213磅)
	设备间隙	右边, 左边, 后面 - 254毫米 (10英寸), 前面 - 940毫米 (37英寸)
处理腔体	最大容量	FlexTRAK-CD: 5.5升 (338立方厘米)
		FlexTRAK-CDS: 9.6升 (585立方英寸)
电极	多种电极配置	电源-接地、接地-电源、电源-电源
	工作区	FlexTRAK-CD: 305毫米 (宽) x 305毫米 (长) (12英寸 (宽) x 12英寸 (长)) FlexTRAK-CDS: 305mm宽x550mm长 (12英寸宽x21英寸长)
射频电源	标配电源	600 瓦
	流量计	13.56 兆赫
气体控制	可用流量	50、100或250标准毫升/分钟
	MFC最多可配置数	3
控制和接口	软件控制	外部外设控制器 (EPC), 配有PC端触摸屏界面
	远程接口	SMEMA接口、SECS/GEM协议
真空泵	标准干泵	16立方英尺/分钟
	选配湿泵	19.5立方英尺/分钟
	选配净化干泵	16立方英尺/分钟
	干泵净化氮气用量	2升/分钟
设施	电源	220 伏交流电, 15安培, 50/60赫兹, 1相, 12 AWG3线
	工艺气体管径及接口	外径6.35毫米 (0.25英寸) Swagelok管
	工艺气体纯度	实验室或电子等级
	工艺气体压力	最小0.69巴 (10磅/平方英寸) 至最大1.03巴 (15磅/平方英寸), 可调节
	净化气体管径及接口	外径6.35毫米 (0.25英寸) Swagelok管
	净化气体纯度	实验室或电子等级 N2/CDA
	净化气体压力	最小2巴 (30 磅/平方英寸) 至最大6.9巴 (100 磅/平方英寸), 可调节
	气动阀配接口及管径	外径6.35毫米 (0.25英寸) Swagelok管
	压缩气体纯度	CDA、无油、露点温度 $\leq 7^{\circ}\text{C}$ (45°F)、粒径<5微米
	压缩气体压力	最小3.45巴 (50 磅/平方英寸) 至最大6.89巴 (100 磅/平方英寸), 可调
	排放	外径25.4毫米 (1英寸) 管道法兰
合规性	半导体	通过SMEI S2/S8 (环境、健康和安全/人体工学) 认证
	国际	通过CE认证
辅助设备	气体发生器	氮气 (需要其他不可选硬件)

MARCH FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS

FlexTRAK-CD

FlexTRAK-CD系统拥有一个等离子腔，每个等离子周期内可处理多达5根料条。均匀处理所有基底表面的同时，始终严格控制工艺参数以获得可重复性效果。此外，系统还拥有一个获得专利的等离子体模块，可实现优异的均匀性和跨周期的工艺可重复性。



FlexTRAK-CDS

FlexTRAK-CDS系统具有大容量等离子腔体，每个等离子周期内可处理多达10根料条。均匀处理所有基底表面的同时，始终严格控制工艺参数以获得可重复性效果。



MARCH FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS

系统核心功能

诺信电子方案事业部致力于在全球范围内提升电子产品的可靠性。数十年来，我们为提高半导体产品的可靠性提供服务和解决方案而深感自豪。无论您身在何处，均可生产或购买我司具有可靠性的产品。FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS系统可对半导体应用中的条形组件进行高产能化加工，其设计经久耐用，具有延续悠久传统的前沿功能。

深入了解FlexTRAK-CD和FlexTRAK-CDS的功能。继续了解我们是如何面向未来的。

欲了解更多信息，请发送邮件至info-electronics@nordson.com与我们联系

核心功能	可靠、经济 高效型等离 子处理。	这类自动化系统结构紧凑，可均匀处理微电子原件，适用于先进的半导体封装应用。维护成本低，可靠性强，且拥有成本极低。
------	------------------------	--

欲了解更多信息，请访问我们的网站，找到您当地的区域办事处或客服代表进行咨询。
我司在全球拥有多个服务网点。

北美
亚太地区
欧洲、中东和非洲

www.nordson.com/electronics
info-electronics@nordson.com

中国

苏州 +86 512 6652008
虎丘区浒墅关镇永安路19号上市科创园8号楼

东莞 +86 18521370905
松山湖总部二路金百盛产业园依时利大厦C区一楼

北京 +86 10 84536388
朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1205

上海 +86 21 38669166
浦东新区张江高科技园区郭守敬路137号

广州 +86 20 87220092
黄埔区神舟路18号润慧科技园C701/706, E101/102

台湾 +886 29021860
新北市新莊区中正路 657-12号3楼



北美总部
西洛克大道2747号
美国加利福尼亚州卡尔斯巴德，邮编：92010-6603

+1.760.431.1919

2023年4月


Nordson
ELECTRONICS SOLUTIONS